半導體設備產品比較表

Product model		VF-5900	VF-5700	VF-5300	VF-5100	VF-3000	VF-1000	Model 200	RLA-3100	RLA-1200	SO2-12-F	VFS-4000	Model 206A	RLA-3100-V	RLA-4106-V	VF-5300HLP	VF-5300H	VF-3000H	VF-3000HS	CLH Series
晶圓尺寸	φ300mm	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	φ200mm	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	最大φ150mm	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	其他	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
批量大小 [最大存放數 / 系統]	φ300mm	100	50	-	-	-	25	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	φ200mm	-	-	150	150	50	25	125	1	1	100	-	-	1	1	100	75	-	50	200
	最大φ150mm	-	-	200	150	75	50	150	1	1	-	-	-	1	1	100	50	50	75	200
	其他 (矩形基板等)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	800	-	-	-	-	-	-	25
傳輸系統	晶圓 (基板)	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	盒式堆料器	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	FOUP開口器	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOUP儲料器	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
系統	直立式爐管	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
	橫型爐管	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	燈退火系統	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○
	潔淨烤箱系統	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大口徑直立式爐管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	SiC功率半導體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-
半導體	退火	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-
	熱氧化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-
	LPCVD (SiN, Poly-Si (Non-Doped, P-Doped) TEOS, HTO)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	活化退火			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	雜質擴散	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	聚酰亞胺固化	○	○	○	○	○	○		-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	吸雜	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	燒結/合金	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SiC功率半導體	活化退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
	熱氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	氮化/氧氮化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	LPCVD (TEOS)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POA	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	接觸退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
MEMS	熱氧化	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LPCVD	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCSEL	熱氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接觸退火	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV (光電)	雜質擴散		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	熱氧化	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
包裝	聚酰亞胺固化	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
FPD	固化 (聚酰亞胺固化)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○
	活化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	脫氫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	熔塊燒製	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	金屬接觸退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-